

## 编者按:

12月11日,由工业和信息化部、上海市人民政府指导,中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院主办,北京赛迪会展有限公司、中国电子报社、上海市集成电路行业协会承办的首届全球IC企业家大会在上海举办。大会除一个主论坛外,还举办了六场分论坛。大会期间,与会嘉宾围绕全球半导体产业如何开放发展、合作共赢,围绕集成电路市场、技术、研发、投资等热点发表了精彩演讲,本报特摘编嘉宾演讲内容,以飨读者。(详见2~7版)

中国半导体行业协会理事长周子学:

## IC产业须采取开放包容的态度

本报记者 诸玲玲

“中国半导体行业协会将坚定不移地秉承开放发展、合作共赢的理念,为中外的企业搭建交流、合作的平台,推动半导体产业取得更大的进步。”



周子学表示,IC China首次举办了全球IC企业家大会,邀请了近60位中外企业家、专家、学者,就市场、技术、研发、投资等内容进行了精彩演讲,业内人士一定会有裨益。

周子学介绍说,IC China已经成功举办了15届,今年的IC China展会面积达到了1.2万平米,来自设计、制造、封装、设计工具、设备、材料等产业链各个环节的200家企业参展。国际行业组织如韩国半导体行业协会首次组织企业集体参展,国内各个地方的半导体协会、IC设计基地也设置了专门的展区。

周子学说,2018年是中国改革开放40周年,也是集成电路发明60

周年。40年的改革开放给中国带来了翻天覆地的变化,带来了中国的现代化;60年前发明的集成电路,给人类带来了巨大的、革命性的进步。

半导体产业是全球性的产业,任何一个国家想要封闭起来自己做都不可行。中国发展半导体产业离不开世界,同样的,世界也需要中国,因为中国是最大的半导体市场。所以,我们只有以开放、包容的态度,加强合作,才能够实现共赢互利。周子学强调,中国半导体行业协会将坚定不移地秉承开放发展、合作共赢的理念,为中外的企业搭建交流、合作的平台,推动半导体产业取得更大的进步。

美国半导体行业协会轮值主席Matt Murphy:

## 中国是美国公司的关键市场

本报记者 张心怡

“很多美国公司在在中国投资,在设计、制造、封装、测试环节参与中国半导体供应链,与中国的OEM厂商建立了紧密的合作关系。”



由工业和信息化部、上海市人民政府指导,中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院主办,北京赛迪会展有限公司、中国电子报社、上海市集成电路行业协会承办的“首届全球IC企业家大会暨第十六届中国国际半导体博览会”于12月11日—13日在上海举办。

美国半导体行业协会轮值主席、Marvell公司总裁兼首席执行官Matt Murphy表示,半导体行业是一个跨国界、全球互联的行业。美国半导体行业协会代表了美国90%的半导体从业公司,与美国华盛顿和全球各地的主要城市保持合作,通过鼓励创新推进业务增长,驱动

国际公平竞争。如今,全球半导体市场规模达到4000亿美元,为AI、智能网联汽车、物联网等行业的快速增长注入动力。在全球各地,半导体行业都是一个蓬勃而兴旺的产业,潜藏着无限机遇,中国应更广泛地参与全球半导体行业的发展。

他同时表示,中国是一个令人赞叹的半导体市场,也是众多美国公司眼中的关键市场。他担任CEO的Marvell公司在上海、北京、成都、南京等城市设立创意中心,许多在加利福尼亚的员工也来自中国,用才华推动Marvell的创新发展。Matt Murphy表示,中国是世界上增长最快的半导体市场,2017

年的市场需求占到了全球半导体需求的32%。很多美国公司在中国投资,在设计、制造、封装、测试环节参与中国半导体供应链,与中国的OEM厂商建立了紧密的合作关系。

Matt Murphy希望,中美能在多个领域携手合作。例如,中美双方应提高市场的开放程度,反对市场歧视行为。开放的市场对以市场为导向的IC企业具有重要意义,将为下一代ICT产品和IC产品的创新发展提供更多机遇。他期待,中美双方能共同为半导体行业带来建设性解决方案,推动中美企业实现“开放发展、合作共赢”,为全球半导体产业发展做出贡献。

## 坚持中国特色新型工业化道路 建设制造强国

(上接第1版)其中,制造业规模自2010年以来连续9年位居世界第一。创新能力大幅增强。航空航天、船舶和海洋工程装备、轨道交通、机床等领域重大创新成果竞相涌现。产业结构持续优化。2015年至2017年,工业战略性新兴产业增加值较上年分别增长10.0%、10.5%和11.0%。装备制造业和高技术产业快速发展,2017年,装备制造业、高技术制造业占规模以上工业增加值的比重达到32.7%、12.7%。一批骨干企业和龙头企业脱颖而出。进入世界500强的企业由1995年的3家增至2018年的120家,其中制造企业达到60家。

(二)两化融合持续深入推进。近年来,我们把两化融合作为新型工业化的主线及制造强国和网络强国建设的结合点,努力推动信息化与工业化深度融合。制造业信息化水平大幅提升。2017年,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率、生产设备数字化率、数字化设备联网率已分别达到63.3%、46.4%、44.8%和39%,制造业智能主导的特征日趋明显。工业互联网建设取得重要进展。工业互联网技术标准、网络建设、平台培育、安全保障、融合应用等全面推进,中国自主

研制的工业以太网、工业无线网络技术被纳入IEC国际标准,建设了十余个工业互联网网络新技术测试床,工业互联网平台数量快速增长,有一定行业区域影响力的平台超过50家,工业设备连接数量超过10万台套,在钢铁、航空航天、汽车、电子等多个行业,涌现出一批融合应用创新。数字经济高速发展。7家互联网企业进入全球互联网公司市值前20名,电子商务、网上购物、移动支付等一批新模式正在引领世界潮流。2017年,我国数字经济规模达27.2万亿元,同比增长20.3%,占GDP比重为32.9%,总量位居世界第二位。

(三)供给侧结构性改革向纵深推进。我们深刻把握供给和需求对立统一辩证关系,主动适应和引领经济发展新常态,以及国际金融危机发生后综合国力竞争新形势,大力推进“三去一降一补”。超额完成去产能任务。2013年至2015年,全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢5700万吨、电解铝110万吨、水泥2.4亿吨、平板玻璃8000万重量箱。2016年至2017年钢铁行业去产能1.2亿吨,提前完成化解钢铁产能年度预定目标任务。企业成本负担进一步降低。发挥国务院减轻企业负担部际协调联席会议机制作用,推动建立涉企收费清单管理,为企业减负超过1000亿元,取消涉企保证金项目150项以上。推动出台关于金融支持制造强国建设的指导意见,疏通金融进入实体经济的渠道,降低企业融资成本。质量品牌稳步提升。连续7年开展工业质量品牌建设专项行动,形成了质

量标杆、质量控制和技术评价实验室建设、企业品牌培育、产业集群区域品牌建设等一批有影响力的标志性活动。针对量大面广的日用消费品,深入实施“增品种、提品质、创品牌”专项行动,推动中高端消费品供给能力、消费品品质、品牌竞争力进一步提升。

(四)扩大对外开放取得新进展。开放是国家繁荣发展的必由之路。40年来,我们顺应经济全球化大势,深度融入世界经济,推动形成工业和信息化领域全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。在“引进来”方面,建立了“准入前国民待遇+负面清单”的外商投资管理制度,基本实现了全面放开一般制造业,在中国的跨国公司近2000家。在“走出去”方面,2017年我国货物进出口总额达到4.1万亿美元,是1978年的783倍。制造业占海外投资比重超过1/3。在协同发展方面,与30多个国家签署了产能合作协议,一批境外产业园区相继落成。与德、法、美等国在战略对接、标准制定及智能制造、工业互联网等方面对话合作务实开展。

### 三、坚定不移推动工业和信息化事业高质量发展

没有改革开放就没有工业和信息化事业的发展壮大。从落后的农业国到世界第一的制造大国,改革开放40年特别是党的十八大以来的探索实践,在工业和信息化发展道路、指导思想、制度创新、治理体系等方面积累了宝贵经验,丰富了中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的内涵,也成为推进新时代工业和信息化事业高质量发展的宝贵财富。

(一)坚持和加强党的全面领导。党政军民学,东西南北中,党是领导一切的。改革开放40年来我们取得的成绩,离不开党中央的坚强领导,离不开党中央一锤定音、定于一尊的权威。当前,全面深化改革进入攻坚期和深水区,改革的复杂性敏感性艰巨性更加突出,要当好新时代的“答卷人”,就必须毫不动摇坚持和加强党的全面领导,充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用,坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,保持坚如磐石的战略定力,确保工业和信息化改革发展始终走在正确方向上。

(二)坚持全面正确履行政府职能。我们顺应技术和产业发展趋势,更好发挥政府作用,加强战略谋划,引领工业和信息化发展。完善发展政策体系,出台一系列指导性文件。注重发挥地方政府作用,实现“横向联动,纵向贯通”的联动机制。持续开展两化融合试点示范,制定了两化融合管理体系国家标准,遴选近200个制造业与互联网融

合发展试点示范,以及100多个制造业“双创”平台试点示范。实施工业互联网平台建设及推广工程。积极推动有线、无线宽带网络建设发展,打造若干个面向中小企业的公共服务平台。同时,我们始终坚持以人民为中心的发展思想,坚持改革为了人民、改革依靠人民、改革成果由人民共享,注重解决人民群众反映的突出问题,采取有力举措加强质量品牌建设、强化安全生产措施、打击通讯信息诈骗、助力脱贫攻坚,使人民群众获得感不断增强,满意度不断提高,工业通信业改革发展成效更加凸显。

(三)坚持营造公平竞争的市场环境。我们着力深化“放管服”改革,2013年以来取消下放行政审批事项28项、占比近50%,非行政许可审批事项全部取消,放宽了电信、军工等领域行业准入限制;创新行业管理方式,加强事中事后监管,改进公共服务,切实把该管的管好,不该管的交给市场、交给社会,有效激发了市场主体活力和创造力;积极配合“营改增”等重大改革,推进装备制造、电力、钢铁等重要领域中央企业重组整合,完善研发费用加计扣除、企业投资项目核准、设备加速折旧等政策,促进完善工业研发、投资和技术改造政策环境。

(四)坚定持续推进制造强国建设的信心。改革由问题倒逼产生,又在不断解决过程中深化。在推进制造强国建设的伟大征程中,工业和信息化战线不乏风险挑战。在党中央、国务院的坚强领导下,我们进一步强化责任担当,依靠巨大的中国市场,充分发挥制造业韧劲强和回旋余地大的优势,大力推动创新驱动发展,不断催生新的经济形式、新的业态,努力拓展全新发展空间,积极应对国际金融危机,有理有力有节应对中美经贸摩擦,使制造强国建设迈出实质性步伐。只要保持改革开放战略定力,按照既定“路线图”推动制造业向产业链中高端迈进,我们一定能化不利为有利,转危为机,解决好改革发展中存在的问题,实现中国从制造大国向制造强国的转变。

当前,我们迎来了世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期,工业和信息化战线推动改革发展的决心决不能动摇、勇气决不能减弱。我们必须更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,更加坚定“四个自信”,更好践行“两个维护”,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,在新一轮改革开放的大潮中更加坚决地贯彻落实好党中央决策

部署,扛稳担牢推进制造强国和网络强国建设这一光荣使命,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

(来源:《中直党建》杂志)

(上接第1版)2001年以来,年均复合增长率16.4%,2017年市场规模1.4万亿元。中国市场快速增长成为全球集成电路产业发展的主要动力之一,在华收入为跨国公司的成长贡献重要力量。

罗文指出,本届大会以“开放发展,合作共赢”为主题,这是全球集成电路产业60年持续发展的宝贵经验,也是中国集成电路产业持续发展的必然选择。就集成电路产业发展,罗文提出以下建议:

一是坚持开放发展,共享机遇。加大开放力度,深化国际合作层次,持续推进产业链各环节创新发展。持续增长的中国市场,将继续给全球产业提供更多市场空间、投资合作机遇。二是坚持优化环境,共同发展。落实好现有支持集成电路产业发展的政策,内外资一视同仁,推动要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合,营造公平、透明的市场环境。三是坚持市场导向,共建生态。充分发挥市场配置资源的决定性作用,以企业为主体,引导产业优化布局。四是坚持融合创新,共享未来。围绕云计算、大数据、人工智能、工业互联网等重大应用需求,与全球集成电路产业界一道,做大市场蛋糕,实现合作共赢。

吴清在致辞中表示,上海全力落实国家战略部署,把加快发展集成电路产业作为上海建设具有全球影响力的科技创新中心的重要支撑点,通过加强技术研发、完善政策环境、推动产业链结构优化等举措,基本形成设计、制造、装备材料三足鼎立态势,上海成为国内产业链最完整、产业集中度最高、人才最集聚的区域。

吴清说,上海不断优化产业发展生态环境,致力于把集成电路打造为“上海制造”品牌的重要代表。近期,上海又启动建设了集成电路设计产业园,着力引进和培育世界一流的企业,力争打造具有世界先进水平的集成电路专业园区。同时,在工信部的大力支持下,上海正在积极推进国家集成电路创新中心和国家智能传感器创新中心建设,加快提升原始创新能力,不断扩大集成电路产业的规模,全力打造国内产业链最为完整、技术水平最先进、最具竞争力的集成电路产业体系。

他期待世界各地企业家坚持“开放发展,合作共赢”,融入上海集成电路产业发展的大潮,群策群力为上海的高端制造业发展贡献智慧、贡献力量,并希望工业和信息化部等国家有关部门继续关心支持上海的集成电路产业发展。

周子学表示,2018年全球半导体市场继续保持快速增长态势,中国集成电路产业依然保持高速增长。半导体产业是一个国际化非常高的产业,任何一个国家和地区不可能包打天下,一定是采取开放、包容的姿态,互相取长补短,才能实现共赢。中国半导体行业协会将秉承开放、合作的理念,努力为行业搭建合作交流的平台,为政府服务、为产业链服务、为企业服务。

Matt Murphy表示,中美之间有大量合作,涉及许多全球半导体产业的关键企业。中国是世界上增长最快、规模最大的单一半导体成品市场,去年需求占全球半导体市场的1/3。为了促进产业繁荣,中美双方需要

携手合作,共同维护全球半导体市场的开放、公平、尊重与合作。

在上午的开幕演讲环节,紫光集团有限公司联席总裁刁石京就中国芯片产业发展,Cadence公司CEO陈立武就数据驱动经济,三星电子全球高级副总裁Greg Yang,瑞萨电子株式会社高级副总裁、瑞萨电子中国区董事长真冈朋光就中国业务发展,SEMI(国际半导体产业协会)总裁兼首席执行官Ajit Manocha就半导体产业新契机,中国半导体行业协会常务副理事长兼秘书长、中国电子信息产业发展研究院院长卢山就新形势下集成电路企业的机遇和选择做了演讲。

在下午的主旨演讲环节,国家集成电路产业投资基金总裁丁文武就产业发展历程和前景,美国半导体行业协会副总裁Jimmy Goodrich就全球半导体产业链建设,华润微电子有限公司常务副董事长陈南翔就产业的新挑战新机遇,美国高通公司中国区董事长孟樸就5G新生态,英飞凌科技公司大中华区总裁苏华就数字经济“芯”时代,安谋科技(中国)有限公司执行董事长兼CEO吴雄昂就智能互联,RISC-V基金会主席Krsti Asanovic就芯片开源架构,武岳峰资本创始合伙人武平就产业机会做了演讲。

中国科学院院士、复旦大学校长许宁生,工信部电子信息司副司长吴胜武,上海市经济委副主任傅新华、张建明,日本半导体行业协会代表Toyooki MITSUI,韩国半导体行业协会CEO Nam Kiman,中国半导体行业协会常务副秘书长宫承和,中国科学院微电子研究所所长叶甜春,上海市集成电路行业协会理事长、上海华虹(集团)有限公司董事长张素心等出席了会议。

来自中国大陆、美国、德国、英国、法国、日本、韩国以及中国台湾等十多个国家和地区的企业家和专家学者齐聚上海,共享发展成果,共商发展大计。中国半导体行业协会及理事单位负责人,有关高校、行业协会负责人以及产业链上下游主导企业代表也出席了会议。

本次大会除主论坛外,12月12日还举办了6场分论坛:集成电路设计技术与创新论坛、先进封装技术创新论坛、集成电路产业链创新发展论坛、半导体产业投资与创新论坛、2018年海峡两岸(上海)集成电路产业合作发展论坛、RISC-V创新应用暨开发者论坛。分论坛突出专业、专注特色,为新技术、新产品落地、产业链协同合作搭建平台。

与大同期举办的第十六届中国国际半导体博览会(IC China 2018),作为半导体领域最顶级的展会活动之一,共设立半导体设计、半导体制造封测、设备材料、创新应用、分立器件、高端芯片和推广应用六大展区,参展企业达200多家。紫光集团、华润微电子、大唐电信等IDM企业,中芯国际、华虹宏力、华力、和舰等晶圆代工企业,长电科技、华天集团、通富微电、晶方半导体等封测企业,北方华创、电科装备、中科飞测等设备企业,以及罗德与施瓦茨、东京精密、住友电木等国际公司,日月光集团、联发科技等台资公司携IC设计、IC设备、封装测试、IC制造及IC材料等相关产业的创新成果集中亮相展会。